梱包部品	R	F converter部品表		
シンボル	仕様	備考	使用数	梱包個数
FET	2SK241GR	アルミ箔	3	3
FET	J310	7,730	4	4
FET	2SK30A-Y 5E	または 2SK30A-GR 3A	1	1
FET	RD00HVS1	S/38 ZOROOA GITOA	2	2
TR	2SC1815	RF Converter基板用; Gen基板に含む	1	\
TR	2SA1015	RF Converter基板用: Gen基板に含む	8	\ /
SW Diode	1N4148		26	26
R2.3.4.7		RF Converter基板用: Gen基板に含む	12	12 X
HZ,3,4,7 半固定VR	100kΩ茶黒黄P1/6W.	RF Converter基板用: Gen基板に含む		1/
	10kΩ 表示103	RF基板 RDOOバイアス用: Gen基板に含む	1 4	//
C積層セラミック バリキャップ	0.1uF 表示104 Chip 1SV231「TA」	RF Converter基板用: Gen基板に含む	24	7 \
ノバノー・インン	Chip 15V231 1 IAI	RF Converter基板用; Gen基板に含む		24
IC	78L05		1	1
コイルT1.T2.T4	TOKO 10K 10m角	刻印K3766 / シドA21-30MHz用	3	3
コイルT1,T2,T4	TOKO 10K 10m角	刻印LT:巻き直し必要:バンドBC用	6	6
コイルT9,T10	FB801相当	線巻き必要 Φ0.2UEW	2	2
コイルエフ	FB Φ4x7mmL	T7	1	1
線材	UEWΦ0.22mm	2m/GenキットT5にも使用	1	1
1/2/2/2	OLVV 40.2211111	ZIV CEIT / TOTCOIS 13	 	
ツェナーDiode	RD4.3 or 4.7		2	2
バリキャップ	Chip 1SV287or 239	5pF/2V-0.6pF/25V刻印「TK」or[TC]	3	3
DBM	ADE-1	001724 0.001720420FIF 11(10[10]	1	1
DDIVI	1,02		†	
マイクロインダクター	22uH赤赤黒	Q2,3 Drain ,Q4-5 Source	3	3
マイクロインダクター	47uH黄紫黒	Band C/7-10MHz Q1-Drain	1	1
マイクロインダクター	56uH ラジアル型	Q9 J310入力部	i	1
(1)412777	30di 1 // /// <u>+</u>	(45 0010) (5) HP	-	
R	Chip 100 Ω	1608Chip 表示101	18	25
R	Chip 330 Ω	1608Chip 表示331	2	10
R	Chip 1.2kΩ	2012Chip 表示122	6	15
R	Chip 6.8k Ω	2012Chip 表示682	13	20
R	Chip 22kΩ	2012Chip 表示223	14	20
R	1Ω 茶黒金	P1/6W.	1	1
R5.8	10Ω 茶黒黒	P1/6W.	6	6
R	1kΩ 茶黒赤	P1/6W, RD00HVS1NFB用	2	2
C	220uF25V	TEMPS TO THE TEM	1	1
C	Chip 0.1 μ F25V	1608Chip コンデンサー 104	41	50
				14
C4,7,12, C11	15pF	AB.Cバンド同調用、同値	12	
C5_Cバンド C5 Bバンド	10pF	円板型セミックコンデンサー	1 1	0
	15pF	円板型セデックコンデンサー、上記余剰充当		
	15pF	円板型セミックコンデンサー、上記余乗庁当	1	0
C6_C/、',	2pF	円板型セミックコンデンサー	11	11
C6 Bバンゲ	コンデンサ不要		 	ļ
	1pF	円板型セミックコンデンサー	1_1_	
C8 CV, 가,	10pF	セデックコンデンサー	1	1
C8 B/小小	33pF	セラミックコンデンサー	1	1
	120pF	セラミックコンデンサー	11	11
/ ^	 小選択部	1	+	
	アルステント (1815×9個等よ、PLL)			
10 /41 10000F,20				
PCB基板		100mmx100mm 1.6mm厚ガラスエポ	1	1
ピンヘッダ	1x40p, 1x20P	(1P.1P.1P)x3_3P.3P.3P.2P.3P.19P.8Px2	GenK	itに含む
同軸中ネクタ	大宏TMP	基板半田付け用メス・オス1組	1	1

ř 1k 1.2kΩ Chip ≅ 22kΩ Chip 22k [5] 10k 6.8kΩ Chip [D] 100 Ω Chip

104 0. 1uF Chip

#

331 330Ω Chip ▶ VariCap Chip

104 104 • GD 9104 Œ 0 草末草 000 G Š 104 104 104 5 104 8 DID (181) 104 10k 0k 104 1k 2 -0 104 D 104 O 104 O Ö Ö 104 88 080 104 101 8 10) 10k 10k 104

KP6 RF Converter部製作要領

<梱包部品>

①左表梱包部品のみKITに含まれます。その他の部品は、別途準備ください。 梱包個数にX印を付した2SC1815等は、Generator基板キットにまとめています。 LPFバンド切替用74HC595+他部品類は、PLL Lo基板キットに梱包されています。

②A ,B ,Cバンドの同調コンデンサを固定し、例えば、A(7MHz), B(21MHz), C(50MHz)のよ うな 3パンパとすると調整が格段に容易となります。 同調可変6パンパとするか、固定 3バンドとするかは、適宜決定ください。

③コイルデータ

Aハント・用 T1,T2,T4 TOKO 10Kコイル (刻印K3766); 巻き数8t:6t の既成品で、0.4-1.2uHをカバー。本機では、バリキャプ可変同調21~28MHzですが、固定コンデンサで次のと おり同調します。 10pF→50MHz 30pF→28MHz 50pF→21MHz

B, Cパント 用 T1,T2,T4 TOKO 10Kコイル(刻印LT); 既存は内部巻線36tx1次のみで すが、それを巻きほどき、回路図指定の通りに、同線材で巻き戻します。 1次巻線を 最上段の巻き溝に巻きます。内部コアの上端と ケース上面が一致したときに、最大イン ∮クタンスで、内部コアを最下位置までネジ込んだ状態で最小となります。 1次側ピンの センターに、ダミーピン(抵抗のリート・線を流用)を接着剤で挿入し、外見5Pinとします(1次、2 次の判別のため)。

コイルT7は、フェライトコア ϕ 4mmx7mmL、UEW ϕ 0.22mmにより、製作してください、 参照: 小生HPの「バイファイラ/トリファイラ コイルを巻く| http://www.saturn.dti.ne.ip/~khr3887/Coil.html

⑤ T9,T10の FB801相当品は、FB43-287 でMn系フェライトのため、導電性がありま す(≒20kΩ/1cm)。巻線被覆を傷つけると、巻線~コア間で導通がありますが、性能 的には問題ありません。 が、なるべく傷をつけないように線を巻きます。

⑥ Q7.2SK30Aは、梱包しているものを使用してください。Idss選別をしています。

〈部品の取り付け〉と〈部分的調整〉

基板の部品穴は、スルーホールとなっています。10Kコイルのピン穴(φ0.9mm) は、、φ1mml Julを通して内面メッキを取り除いておくほうがよいでしょう。 また念のためNC端子は、半田付けしないほうが、あとあと万一の場合の 取り外しが容易です。 例えば、10Kコイルは、4本がコイルに接続され、残り1 本はNCです。

1) 部品密集箇所は、各部品ランドが重なっています。半田付けの際、隣 接部品の穴も埋めてしまうことがありますので、隣接部品は全て穴に差し 込んでから半田付けを推奨します。 裏面(パターン面)表面実装部品 は、左記の図面で チップ部品位置を確認してください。

<部品の取り付けの順番;参考まで>

①最初に、Q18,Q19_2SA1015、Q12-Q17、Q20_78L05の電源関連部品を 取り付け、れ、B+5V、送受電圧切替の確認。Key_downにより、Q7_J310ト レイン電圧がON/OFFすることを確認して下さい。RD00HVS1のパイアス調整 10kVRは、左側(0V)に回し切っておきます。

②次に、Q7-Q9_J310、T9のRF Amp関連を取付けます。 まだRD00HVS1 は、取付けません。 T9の2次側(4tx2 バイファイラ)は、片側4t が、50Ωとな りますので、openにしておき、調整の際は、ここに50Ω電力計(AD8307 dBm電力計)を接続し、出力調整します(+10dBm)。 配線後、 B+12V,TB+12V電源投入し、Q8ケート(ALC端子)電圧が5-7Vであることの確認、Q9ソース電圧が、≒0.8V(27mA)であること確認しておきます。

③次に、Band C, B, A, の各バンド毎に 帯域、ゲイン調整しながら、T9 2次 側4tコイル側で(まだRD00HVS1は、未取付)、出力+10dBmとなるように、調 整していきます。 最も難しく、最も楽しい工程?です。Q1, Q2, Q3 2SK241のソース回路は、Band C(100 Ω+n°スコンなし)。B(100 Ω+0.1 uF)。 $C(0\Omega)$ のようにして、各バンドでの出力が同程度となるようにします。

バリキャップ用100kΩは、空中配線となります。製作例写真を参照。

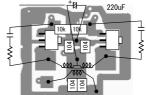
④ 残り部品 DBM,RD00HVS1, J310 RX Amp関連部品を取付けます。

①電源B+12を接続し、受信時電流≒40mA、送信時電流≒70mAの確認。 Q10,Q12 RD00HVS1の 電流は、二つで100mAとなるようにバイアス電 圧を調整します(≒2V)。

② SG信号入力により、このConverter基板単味での 最終段(RD00HVS1 の出力)の 出力≒1.0W を確認する場合は、

DBM出口の TP端子から、SG信号(-10dBm)を入れて確認します。この とき、DBMを取り付け済の場合は、パターンをカットして、DBMは切り離し ます。(レジストのないライン箇所)

RD00HVS1アンプ近傍 部品面 部品配置 表面



<u>δ</u> 10k 6.8kΩ Chip

104 0.1uF Chip



PLL制御危難からの信号は、5Px2ソケットで着脱可接

